

EV Group announces next-generation EVG150 resist processing platform – November 8, 2022

EVG announced that it has strengthened its portfolio of optical lithography solutions with the unveiling of the next-generation 200-mm version of its EVG@150 automated resist processing system. The EVG150 provides reliable and high-quality coating and developing processes in a universal platform that supports a variety of devices and applications, including advanced packaging, MEMS, RF, 3D sensing, power electronics, and photonics. Its high throughput, flexibility and repeatability support the most demanding needs for both high-volume production and industrial development. “Resist processing and patterning are the most repeated process steps in semiconductor manufacturing. EVG has built up many years of experience with these processes, including optical lithography and spin and spray coating, to address the needs of the most demanding customer requirements.” stated Thomas Glinsner, corporate technology director at EV Group.



권·금융 | 부동산 | 중기·벤처 | 전기·수소·하이브리드·자동차 | 테크 | 탄소중립·ESG | 스마트팩토리·자동화 | 태양광·신재생에너지 | 배터리·페배터리

HOME > 스마트팩토리·자동화 > 이슈·트렌드

EVG, 차세대 범용 플랫폼 'EVG150 레지스트 처리 시스템' 출시

☞ 조창현 기자 | ⌚ 승인 2022.11.08 15:03 | 💬 댓글 0

이전 세대 대비 최대 80% 높아진 생산성 기반 대량생산 및 개발에 용이해

[인더스트리뉴스 조창현 기자] MEMS, 나노기술, 반도체 시장용 웨이퍼 본딩 및 리소그래피 장비 분야를 선도하는 EV그룹(이하 EVG)이 리소그래피 솔루션 포트폴리오에 속하는 차세대 200mm 제품으로 'EVG150 자동화 레지스트 처리 시스템'을 출시한다고 8일 밝혔다.



차세대 범용 플랫폼 'EVG150 레지스트 처리 시스템'은 최대 80% 향상된 생산성으로 고객을 지원한다. [사진=EVG]

가장 많이 본

1. 초성출판
2. 미국, 주7
3. [트렌드
4. 비메이에
5. 2030년 3
6. 한국어너
7. 중기부, 6
8. 프로그래
9. 한드칼릿
10. HP, 디지



영상 · 뉴스



새로운 EVG150 플랫폼은 이전 세대 플랫폼 대비 최대 80% 향상된 생산성 및 범용성, 50% 감소한 풋프린트가 특징이다. 또, 유연성이나 반복성도 좋아 대량생산 및 산업용 개발 모두에 활용할 수 있다.

특히 신뢰할 수 있는 범용 플랫폼으로 고품질 코팅 및 현상 공정이 용이해 △첨단 패키징 △MEMS △RF △3D 센싱 △전력 반도체 △포토닉스 같은 다양한 디바이스와 애플리케이션에 적용 가능하다.

실리콘오스트리아랩스 모센 모리디 마이크로시스템연구부장은 “우리는 선도적인 제조회사들과 협력해 인더스트리4.0, 사물인터넷, 자율주행, CPS, AI 등 관련 기술들을 개발하고 있다”며, “차세대 EVG150 레지스트 처리 시스템은 유연성이 뛰어나 우리의 고객들과 함께 EBS 혁신을 촉진하고, 새로운 공정 및 제품의 대규모 구현에도 도움이 된다”고 시스템 도입 소감을 전했다.

EVG 트마스 글린스너 기업테크놀로지디렉터는 “레지스트와 패터닝 공정은 반도체 제조에 있어 가장 반복적으로 사용되는 공정들이며, EVG는 리소그래피와 회전 및 분사 코팅 등의 공정 분야에서 다년간 쌓아온 전문성에 바탕해 고객들의 까다로운 요구를 충족하는 솔루션을 제공한다”라며, “차세대 EVG150 시스템은 이러한 경험을 토대로 탄생한 범용 플랫폼으로 새로운 차원의 생산성과 비용상 이점을 달성하게끔 설계했으며, 뛰어난 유연성으로 다양한 애플리케이션의 레지스트 공정 요구를 충족한다”라고 플랫폼에 대해 설명했다.

신규 출시한 200mm 기판용 차세대 EVG150은 회전 및 분사 코팅, 맞춤형 모듈 구성이 가능한 자동화 플랫폼, EVG 고유의 OmniSpray기술 등 이전 세대 플랫폼이 가진 특성을 그대로 유지하고 있으면서도 최대 4개의 습식 처리 모듈 공간과 최대 20개의 베이크냉각 유닛을 제공해 다양한 웨이퍼를 동시에 처리 가능하다.

아를러 챔버 위치를 변경해 로봇 핸들링 유닛에 접근성이 높아 수월한 유지보수가 가능하며, 이미지 기반 프리알라이너(pre-aligner) 사용으로 신속한 웨이퍼 센터링을 할 수 있다. 또, 시스템 내 레지스트와 화학물질 라인을 통합해 화학물질 저장을 위한 외부 캐비닛 공간 절약 및 장비 풋프린트를 축소하는 등 다양한 기능을 탑재했다.

미라콤아C
스마트팩토리



2022 글로벌
시장

프로카드



<http://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=47728>